



## RE900

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico, rivestito con maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per 14 diversi SMD TSOP I e 7 diversi SMD TSOP II
- Pitch 0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil); 0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
- Diametro del foro 1,00 mm
- Punti di rottura predeterminati per separare i singoli moduli del circuito
- I dati Gerber per la produzione della pasta di saldatura vengono messi a disposizione gratuitamente su richiesta
- Dimensioni 72,60 x 76,20 mm

N. modulo	Tipo	Pitch	Pin	Dimensioni (mm)
RE900-01	TSOP I	0,400 mm	28, 40, 48, 60	12,00 x 18,00
RE900-02	TSOP I	0,500 mm	28, 32, 40, 48	12,00 x 20,00
RE900-03	TSOP I	0,500 mm	20, 24	6,00 x 16,00
RE900-04	TSOP I	0,650 mm	16, 24, 28, 36	12,00 x 14,00
RE900-05	TSOP II	0,800 mm	40, 44	11,50 x 18,80
RE900-06	TSOP II	1,270 mm	20, 24, 26, 28, 32	11,50 x 21,30